Załącznik nr 1 - do **Rozeznania rynkowego na zakup usługi wykonania finalnych prototypów urządzeń EOS na potrzeby testów wewnętrznych oraz testowych sprzedaży do klientów**

1. **Podmiot przeprowadzający rozeznanie rynkowe:**

Sisotech Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku adres: ulica Leśna Polana 10, kod pocztowy 15-575 miejscowość Białystok wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000833651

1. **Dane podmiotu przygotowującego cennik**

Nazwa……………………………………………………………………… Siedziba……………………………………………………………………

Nr telefonu: ……………………………………………………………………

Dane rejestrowe NIP lub nr KRS………………………………………………

Cennik naszej firmy w zakresie przedmiotu rozeznania rynkowego przedstawia się następująco:

1. **w zakresie: Usługi wykonania finalnych prototypów urządzeń EOS - testy wewnętrzne.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa urządzenia | Specyfikacja | Cena wykonania usługi zgodnie ze specyfikacją, ujętą w punkcie III.A z rozeznania rynkowego |
| Zebranie dokumentacji technicznej i przygotowanie dokumentacji wykonawczej | * Dokumentacja PCB w formacie GERBER i PDF |  |
| Przygotowanie obrabiarki CNC pod projekt obudowy (program) | * Przygotowanie programu CNC frezowania obudowy bez ekranu, na podstawie projektu obudowy * Przygotowanie programu CBC frezowania obudowy z ekranem, na podstawie projektu obudowy |
| Wykonanie obudów | * Frezowanie obudów bez ekranu * Frezowanie obudów z ekranem |
| Uzbrojenie maszyny pick & place | * Umieszczenie dostarczonych komponentów, w maszynie pcik & place |
| Montaż elementów na płytach PCB | * Montaż elementów na laminacie PCB, zgodnie z dokumentacją |
| Przeprowadzenie testów oraz wgranie oprogramowania testowego na prototypy | * Zaprogramowanie jednostki centralnej (CPU) * Przeprowadzenie testów zgodnie z dostarczonymi scenariuszami |
| Montaż prototypów w obudowie | * Umieszczenie płyty PCB w obudowie, oraz montaż śrub mocujących |
| Pakowanie | * Pakowanie gotowych urządzeń w pudełko |
| SUMA | |  |

1. **w zakresie: Usługi wykonania finalnych prototypów urządzeń EOS na potrzeby testowych sprzedaży do klientów**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa urządzenia | Specyfikacja | Cena wykonania usługi zgodnie ze specyfikacją, ujętą w punkcie III.B z rozeznania rynkowego |
| Wykonanie obudów | * Frezowanie obudów bez ekranu * Frezowanie obudów z ekranem |  |
| Uzbrojenie maszyny pick & place | * Umieszczenie dostarczonych komponentów, w maszynie pcik & place |
| Montaż elementów na płytach PCB | * Montaż elementów na laminacie PCB, zgodnie z dokumentacją |
| Przeprowadzenie testów oraz wgranie oprogramowania testowego | * Zaprogramowanie jednostki centralnej (CPU) * Przeprowadzenie testów zgodnie z dostarczonymi scenariuszami |
| Montaż urządzenia w obudowie | * Umieszczenie płyty PCB w obudowie, oraz montaż śrub mocujących |
| Pakowanie | * Pakowanie gotowych urządzeń w pudełko |
| SUMA | |  |

Data: Podpis